

NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

※本リリースは 2022 年 5 月 9 日に発表されたリリースを訳したものです

**タワーセミコンダクター、高電力・高電圧 IC を支える最先端の
パワーマネジメントプラットフォームを拡充**

**動作電圧を 24V にまで拡張し、オン抵抗を 20% 低減した第 2 世代の 65nm BCD スケーラブルパワー
LDMOS ; および素子分離オプションとしてディープトレンチアイソレーション(DTI)を追加することで、125V まで
の動作で最大 40% のダイサイズ縮小を可能にした 180nm BCD プラットフォームをリリース**

**タワーは、ドイツ、Nürnberg で開催される PCIM カンファレンス 2022 で
最新のパワーマネジメント技術について発表**

イスラエル ミグダル ハエメク 2022 年 5 月 9 日 - 高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファンドリである [タワーセミコンダクター](#) (NASDAQ/TASE:TSEM) は、本日、最新の 65nm BCD の第 2 世代をリリースしました。動作電圧を 24V にまで拡張し、オン抵抗を 20% 削減する進化したパワーマネジメントプラットフォームです。さらに、180nm BCD プラットフォームについては、素子分離オプションとしてディープトレンチアイソレーションを追加することで、125V までの電圧範囲で最大 40% のダイサイズ縮小を可能にしたことを発表しました。今回の発表は、より高い電圧と電力効率を有するパワー IC に対する需要が高まっていることに対応しており、2026 年までに 255 億ドルを超えるパワー IC 市場 (Yole Développement: Yole 社による市場調査より) をサポートするタワーのリーディングポジションをさらに強化します。

タワーの 65nm BCD プラットフォームは、90nm よりも微細な BCD 分野で電力性能、コスト、使い易さにおいて最先端の性能指数を有することが知られています。第 2 世代の 65nm BCD は、LDMOS デバイスのオン抵抗低減によって消費電力とダイサイズ指標を最大 20% 良化させると同時に、動作電圧上限を 16V から 24V にまで拡張しました。これらの進化は、充電器、高出力モータードライバ、各種電力変換器などの用途に加えて、コンピューティングや消費者市場での CPU および GPU 用の高出力電圧レギュレータなどを含むモノリシック高出力変換機の要望にもしっかりと対応しています。

同社の 180nm BCD は、適用電圧範囲、素子分離方式、電力性能、ダイサイズ、マスク数などにおいて、業界で最も幅広

い選択肢を有する競争力あるプラットフォームです。180nm BCD ディープトレンチアイソレーション方式(DTI)は、IC 内部でのノイズ耐性を向上させます。この分離オプション追加によって IC 用途に応じた分離方式の選択肢が増えることで、柔軟な設計が可能になり、最大 40%のダイサイズ削減につながります。これらの特徴は、120V 以上の電圧保持 IC を必要とする 48V システムの市場の展開拡大をサポートする戦略に基づくものです。特に、高電圧ゲートドライバ、電力変換器、モータードライバ、自動車用 48V システムなど、産業用および自動車用アプリケーションに向け、小さなICダイの内部で駆動電圧が異なる複数の回路ブロックを扱う際の絶縁分離性能要望に応えています。

タワーは、2022 年 5 月 10 日~12 日、ドイツ、ニュルンベルクで開催される PCIM2020 に出展します(ブース#6-431)。

タワーのパワーマネジメントテクノロジーの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリ リーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路(IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックストシグナル /CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-image sensor、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、TPSCo が保有する日本の 3 か所(200mm と 300mm)に生産拠点があり、イタリアに設立されている 300mm ファブを ST と共有しています。詳細は <http://www.towersemi.com/>をご覧ください。

###

Tower Semiconductor Company Contact: Orit Shahr | +972-74-7377440 | oritsha@towersemi.com

Tower Semiconductor Investor Relations Contact: Noit Levy | +972-4-604-7066 | noitle@towersemi.com